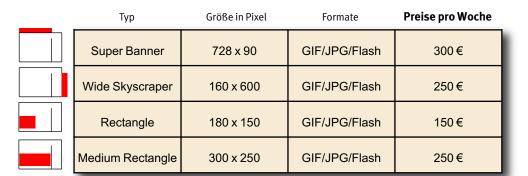


Werbebanner auf www.SMT-Verlag.de



emv-esd

Sie können selbstverständlich auch jedes andere Format wählen, inklusive Video. Bitte fragen sie bei uns an!

Redaktion + Vertrieb

Dipl.-Ing. (FH Jost Dennier info@smt-verlag.de www.smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 1 55218 Ingelheim Tel: +49 (0)6132 4316-47

Fax: +49 (0)6132 4316-49

Anzeigenverkauf

Johann Bylek

Tel: +49 171 412 9443 E-mail: johann.bylek@t-online.de

CADS

MEDIADATEN 2019

THEMEN
TERMINE
PREISE

Fachzeitschrift für Advanced Packaging & Elektronikfertigung



Fachzeitschrift für Elektromagnetische Verträglichkeit & Auswirkung Elektrostatischer Aufladung





emv-esd

lost Dennier Herausgeber:

Dipl.-Ing. (FH) Jost Dennier ₹ Redaktion: Anschrift: Redaktion SMT/CADS/EMV-ESD

Oberer Schenkgarten 1 55218 Ingelheim Tel.: +49 (0)6

+49 (0)6132 43 16 47 Fax: +49 (0)6132 43 16 49 E-Mail: info@smt-verlag.de Web: www.smt-verlag.de

Anzeigen: Johann Bylek

Telefon: +49 171 412 9443

E-Mail: johann.bylek@t-online.de

Inhaber: Jost Dennier

■ Verlag: SMT-VERLAG

Oberer Schenkgarten 1

55218 Ingelheim

Jahrgang: 32. Jahrgang 2019

Erscheinungs-7 x in 2019

weise Erscheinungs-/

Redaktionsplan:

siehe Seite 5/6

Bezugspreise: Jahresabonnement:

Einzelheft: Iahresabo: EMV-ESD

bzw. CADS

58,00 Euro inkl. Versand

9,00 Euro

29,00 Euro inkl. Versand

Kurzcharakteristiken:

»SMT Germanv« ist die Fachzeitschrift für alle Bereiche der Elektronik-Fertigung und des Advanced Packaging.

Schwerpunkte sind:

Baugruppenfertigung, Leiterplattenfertigung, Halbleiterfertigung sowie Test und Qualitätssicherung. Ergänzt werden diese Themen durch Marktübersichten zu den wichtigsten Produkten und Dienstleistungen für die Elektronik-Fertigung.

»CADS« als Supplement von SMT Germany informiert über die Bereiche Entwicklung und Konstruktion in der Elektronik. Redaktioneller Schwerpunkt ist die Design-Automation bei der Anwendung von CA-Techniken wie Verifikation, Design, Routing, Signalintegrität u s w.

»EMV-ESD« ist das kompetente Fachforum für alle Fragen der elektromagnetischen Verträglichkeit und der Auswirkung elektrostatischer Aufladung sowie der messtechnischen Erfassung dieser Erscheinungen.

Zielgruppen sind Fachleute in den Bereichen Konstruktion, Fertigung und Qualitätssicherung in der Elektronik- und Halbleiterindustrie sowie in anderen Industriebereichen, die Elektronik in ihren Erzeugnissen einsetzen.

Smy emv-esd

Auflagen- und Verbreitungsanalyse

Auflagen-Analyse: Intern (30.09.2017 -01.10.2018)

Druckauflage: 9500

Tatsächlich verbreitete Auflage

im Jahresdurchschnitt: 9220

Verkaufte Auflage: 805

Freistücke: 8165 pro Ausgabe

Rest-, Archiv- und Belegexemplare: 250 pro Ausgabe

Geographische Verbreitungsanalyse

Wirtschaftsraum		Anteil an der Auflage in %
Inland Postleitzahl o Postleitzahl 1 Postleitzahl 2 Postleitzahl 3 Postleitzahl 4 Postleitzahl 5 Postleitzahl 6 Postleitzahl 7 Postleitzahl 8 Postleitzahl 9	218 322 528 715 626 720 1128 1957 1608 815	2,4 3,5 5,7 7,8 6,8 7,8 12,2 21,2 17,4 8,8
Ausland Schweiz Österreich Großbritannien Niederlande Sonstiges Ausland	127 118 95 90 153	1,4 1,3 1,0 1,0
Gesamtauflage	9220	100,0

Struktur- und Empfängeranalyse

SMT emv-esd CADS

■ Branchen-/Wirtschaftszweige

Nr. Grund- systematik	Empfängergruppen	Exemplare	%
242	Maschinenbau	621	6,7
243	Datenverarbeitung/ Büromaschinen	158	1,7
244	Fahrzeugbau	231	2,5
248	Luft- und Raumfahrt	294	3,2
250	Elektronikfertigung	3741	40,6
	Unterhaltungselektronik	153	1,7
	Medizinztechn. / Optik	309	3,4
	Leiterplattenhersteller	239	2,6
	Ing. Büros/Dienstleistung	1218	13,2
	Mess- und Regeltechnik	404	4,4
5	Nachrichtentechnik /		
	Verkehr	824	8,9
	Bauelemente-Hersteller	241	2,6
	Stromerzeugung	69	0,7
9	Ausbildung / Forschung	643	7,0
	Sonstige Branchen	75	0,8
Tatsächlich ve	rbreitete Auflage	9220	100,0

■ Betriebsgröße

	Exemplare	%
1 bis 9 Beschäftigte	1466	15,9
10 bis 49 Beschäftigte	1130	12,3
50 bis 99 Beschäftigte	811	8,8
100 bis 499 Beschäftigte	2236	24,3
500 bis 999 Beschäftigte	827	9,0
1000 und mehr Beschäftigte	2750	29,9
	9220	100,0

Betriebliche Funktion

	Exemplare	%
Unternehmensleitung	615	6,7
Techn. Management	2186	23,7
Forschung/Entwicklung	2491	27,0
Konstruktion	721	7,8
Fertigung	1934	21,0
Qualitiätskontrolle, Test	513	5,6
Verkauf	308	3,3
Marketing / Werbung	391	4,2
Studenten	42	0,5
Hochschulen/Sonstige	19	0,2
	9220	100,0

SMI



Preisliste für Anzeigen, Beihefter und Beilagen, gültig ab 01.01.2019

4

Zeitschriftenformat: DIN A4 210 breit x 297 hoch mm

Anschnitt 216 breit x 303 hoch mm

Satzspiegel: 185 breit x 260 hoch mm Anzeigenformate und Grundpreise: Preise in Euro

Format Brei		aße angeschnitten	Preise f	für 4-Farbdruck	(
bei Anzeige	n pro Jahr		1x	2x	4x	6x	8x
1/1- Seite	185 X 260	216 x 303	4.780,00	4.541,00	4.302,00	4.063,00	3.824,00
2/3- Seite	123 x 260 oder 185 x 173	129 X303	3.700,00	3.515,00	3.330,00	3.145,00	2.960,00
1/2 Juniorpa	age 135 x 195	138 x 198	3.260,00	3.097,00	2.934,00	2.771,00	2.608,00
1/2- Seite	93 x 260 oder 185 x 130	96 x 303 oder 216 x 133	2.900,00	2.755,00	2.610,00	2.465,00	2.320,00
1/3- Seite	62 x 260 oder 185 x 87	65 x 303 oder 216 x90	2.420,00	2.299,00	2.178,00	2.057,00	1.936,00
1/4- Seite	46 x 260 oder 185 x 62 oder 93 x 130	96 x 133 oder 216 x 65 oder 49 x 303	1.740,00	1653,00	1566,00	1479,00	1392,00
1/8- Seite	46 x 130 oder 93 x 62 oder 185 x 33	49 x 133 oder 96 x 65 oder 216 x 36	900,00	855,00	810,00	765,00	720,00
1/16-Seite	46 x 62 oder 93 x 31		480,00	460,00	420,00	410,00	390,00

Preise für Vorzugsplätze: 2., 3. und 4. Umschlagseite +15% Sonstige Plazierungsvorschrift: +10% auf den Grundpreis Anschnittzuschläge werden nicht berechnet

Gelegenheitsanzeigen und Stellenangebote

Je mm bei einer Spaltenbreite von 42 mm € 4,00

Einhefter/Einkleber:

Papiergewicht: 80 bis 120 g/m²

2 Seiten (nur Einkleber)	4 Seiten	6 Seiten	8 Seiten	
3 450,00	4 990,00	6 610,00	8 240,00	

Beilagen: Teilbeilagen sind möglich

bis 25 g/1000 inkl. Porto	bis 50 g/1000 inkl. Porto
290,00	390,00

Druckverfahren: Offset

Druckunterlagen: PDF-Dateien als Druckunterlagen werden bevorzugt.

Versandanschrift: SMT-Verlag, Oberer Schenkgarten 1, D-55218 Ingelheim, Tel: 06132 431647, Fax: 06132 431649, E-Mail: info@smt-verlag.de

Aufträge gemäß den Standard-Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Fachzeitschriften.

Bankverbindung:

Jost Dennier Mainzer Volksbank Kto.-Nr.: 787 587 013 BLZ: 551 900 00 BIC-Code: MVBMDE55 IBAN: DE83551900000787587013

Zahlungsbedingungen: Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto oder 20 Tage ohne Abzug.

THEMEN UND TERMINE 2019

Termine	Schwerpunktthemen SMT	Schwerpunkte CADS	Schwerpunkte EMV-ESD	Messen
Ständige Schwerpunkte	Advanced Packaging Baugruppenfertigung Leiterplattenfertigung Test- und Qualitätssicherung Marktübersichten	EDA, Leiterplatten- und Baugruppendesign, Entwurfswerkzeuge, Logikanalyse, Logiksynthese, Simulation	Normung, Messen/Prüfen, Schirmung, Filter, Antennen, Überspannungsschutz, Elektrostatische Entladungen	
Januar/ Februar mit EMV-ESD 1 Messeheft EMV 2019 Redaktionsschluss 06.02.2019 Anzeigenschluss 13.02.2019 Erscheinungstermin 21.02.2019	Packaging, Chip-on-Board, Rework, Bestücktechnik, Schablonendruck Testsysteme, Lötsysteme Marktübersicht: Steckverbinder		EMV-ESD 1 Vorschau EMV 2019 Messtechnik Filter, Stromversorgung Stromversorgung Produktsicherheit	APEX 26. · 31.01.2019 San Diego
März mit CADS 1 Redaktionsschluss 05.03.2019 Anzeigenschluss 13.03.2019 Erscheinungstermin 22.03.2019	Vorberichte »SMTconnect« Packaging, Lötverfahren, Bestückung Sieb-/Schablonendruck AOI, AXI, Flying Prober Schwerpunktthema: MES-Software	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		EMV 19 21.03.2019 Stuttgart Hannover Messe 01 05.04.2019 Hannover
April/Mai mit EMV-ESD 2 Messeheft SMTconnect Redaktionsschluss 02.04.2019 Anzeigenschluss 11.04.2019 Erscheinungstermin 29.04.2019	Vorberichte »SMTconnect« Reparatur/Rework, Löttechnik, Bonden, CSP, Flip Chip, Wafer, Reinraumtechnik Baugruppentest, Halbleitertest, AOI Marktübersicht: Lötsysteme		EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 1 Störfestigkeit Messtechnik Antennen Filter, Stromversorgung ESD, Produktsicherheit	SMTconnect 0709.05.2019 Nürnberg Intersolar Europe 15.0517.05.2019 München
Juni/ Juli mit CADS 2 Redaktionsschluss 06.06.2019 Anzeigenschluss 17.06.2019 Erscheinungstermin 26.06.2019	Nachberichte » SMTconnect « Trends in der Bestücktechnik, Leiterplatten, Microvias, HDI Packaging, Bonding AOI, AXI, Flying Prober Marktübersicht: Schablonendruck	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		CeBIT 24 28.06.2019 Hannover
			EMV-ESD-Anbieterübersicht	
August/ September mit EMV-ESD 3 Redaktionsschluss 14.08.2019 Anzeigenschluss 22.08.2019 Erscheinungstermin 05.09.2019	Bestückung, Dosiereinrichtungen Löten, AOI, AXI, Flying Prober, Packaging, Chip-on-Board, Rework Schwerpunktthema: Röntgentechnik		Teil 2 Messtechnik Dienstleistungen Störfestigkeit Produktsicherheit	Motek 07 10.10. 2019 Stuttgart
				parts2clean 22 24.10.2019 Stuttgart
Oktober mit CADS 3 Redaktionsschluss 11.09.2019 Anzeigenschluss 18.09.2019 Erscheinungstermin 30.09.2019	Vorberichte »productronica« Löttechnik, Bestücktechnik Packaging, Underfill, Bonding Testautomation, Boundary Scan Marktübersicht: Bestücksysteme	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		Semicon Europe 12 15.11.2019 München productronica 12 15.11.2019 München
				SPS/IPC/DRIVES 26 28.11.2019 Nürnberg
November mit EMV-ESD 4 MESSEHET »productronica 2019« Redaktionsschluss 15.10.2019 Anzeigenschluss 22.10.2019 Erscheinungstermin 04.11.2019	Vorberichte »productronica« Leiterplatten, Microvias, HDI Leiterplattenfertigung, Schablonendruck, Löttechnik Schwerpunktthema: Rework und Repair		EMV-ESD 4 Laboreinrichtungen ESD, Überspannung Störfestigkeit Antennen, Messtechnik	Numberg